

崇达技术股份有限公司

关于子公司普诺威与昆山市千灯镇人民政府签署

端侧功能性 IC 封装载板项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2026年1月22日，为满足崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，进一步提升公司在高端集成电路载板领域的核心竞争力，特别是把握端侧芯片快速发展带来的市场机遇，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司普诺威与昆山市千灯镇人民政府签署端侧功能性IC封装载板项目投资协议的议案》，公司控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称“普诺威”）与昆山市千灯镇人民政府签署了《江苏普诺威端侧功能性IC封装载板项目投资协议书》，普诺威拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设“端侧功能性IC封装载板项目”。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。

二、合作对手方介绍

- 1、单位名称：昆山市千灯镇人民政府
- 2、统一社会信用代码：11320583014190191E
- 3、住所：昆山市千灯镇汉昆路 9 号
- 4、单位类型：政府机关
- 5、关联关系：与公司不存在关联关系

- 6、是否为失信被执行人：否
- 7、昆山市千灯镇人民政府与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的其他关系。

三、项目基本情况

- 1、项目名称：江苏普诺威端侧功能性 IC 封装载板项目。
- 2、项目地点：江苏省昆山市千灯镇宏洋路西侧、七浦路北侧。
- 3、项目内容：投资建设用于端侧芯片等高端应用的集成电路封装载板生产基地，涵盖生产厂房、研发设施及附属配套设施。
- 4、实施主体：普诺威。
- 5、投资规模与资金来源：本次项目总投资为人民币 10 亿元，资金来源为普诺威自有资金及自筹资金。

四、合作协议的主要内容

1、协议主体

甲方：昆山市千灯镇人民政府

乙方：普诺威

2、合作主要内容

- (1) 投资主体：乙方作为本项目的拿地主体和建设主体，全面负责项目的规划、建设、运营及相关事宜。
- (2) 投资金额：项目总投资 10 亿元，总工业固定资产投资 8 亿元(包括土地、设备、建筑物、附属设施及其无尘车间装修等，含税价计算)。
- (3) 项目用地：项目总用地面积约 31.5 亩，乙方将通过“招拍挂”方式合法取得项目地块土地使用权。项目用地挂牌地价参照资规部门相关文件规定通过评估方式确定。
- (4) 项目建设期：项目拟于 2026 年 5 月土地挂牌，2026 年 9 月开工建设，2028 年 9 月建成投产。最终建设进度以实际情况为准。

3、双方主要权利和义务

甲方主要负责按约定提供项目用地，并协助乙方办理项目报批报建等相关手续，提供良好的投资环境与服务。

乙方负责按协议约定投资、建设、运营项目，确保按时开工、投产，并努力实现约定的经济效益和社会效益（销售及税收指标）。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资是公司基于整体战略规划，紧抓 AI 技术发展浪潮，特别是端侧设备对高性能、高密度封装载板迫切需求的重要举措。项目旨在扩大公司在高端 IC 载板领域的产能规模与技术优势，优化产品结构，提升在半导体封装产业链关键环节的竞争力和市场占有率，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

(1) 审批风险：本协议需满足生效条件（包括政府评审及公司内部审议）后方可生效，存在不确定性。项目用地需通过“招拍挂”程序取得，最终能否竞得存在不确定性。

(2) 实施风险：项目建设涉及规划、环评、施工许可等多个环节，工期较长，在实施过程中可能面临宏观经济、产业政策、市场环境变化以及工程施工管理等不确定因素影响，导致项目未能按期竣工投产的风险。

(3) 市场与经营风险：项目主要面向端侧功能性 IC 封装载板等市场，技术迭代迅速，市场需求可能发生变化。若未来市场开拓不及预期或行业竞争加剧，可能导致项目投产后无法达到预期的销售和效益目标。

(4) 资金风险：项目投资金额较大，虽然计划以自有资金或自筹资金解决，但仍可能对公司现金流造成一定压力，且融资成本受宏观经济和金融市场环境影响。

公司将积极关注项目后续进展，审慎决策，强化项目管理，努力防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本协议的签署有利于公司长远发展，对公司高端电子电路板块的产业布局

具有积极战略意义。本项目投资建设周期较长，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

六、其他说明

本次签署的投资协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体实施尚需履行公司内部审议程序及土地“招拍挂”等法定程序，项目最终的投资金额、建设进度等存在不确定性。

公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、《江苏普诺威端侧功能性 IC 封装载板项目投资协议书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十三日